
浙江华正新材料股份有限公司
2019 年度非公开发行 A 股股票预案

二〇一九年四月

发行人声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次非公开发行完成后，本公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

重大事项提示

本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。

1、本次非公开发行A股股票的相关事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会审议通过以及中国证监会核准后方可实施。

2、本次发行对象为包括公司控股股东华立集团或其指定的控制的企业在内的不超过10名特定对象。除华立集团或其指定的控制的企业外的发行对象为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式一次性认购。

3、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的百分之九十且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产的价格。

其中，定价基准日前20个交易日发行人股票的交易均价=定价基准日前20个交易日发行人股票交易总额/定价基准日前20个交易日发行人股票交易总量。如公司在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。若公司在截至定价基准日最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则上述归属于母公司普通股股东每股净资产值将进行相应调整。

最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，按照相关法律法规的规定及监管部门要求，根据竞价结果由公司董事会在股东大会授权范围内和保荐机构（主承销商）协商确定。华立集团或其指定的控制的企业将不参与市场询价过程，但接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。

4、根据中国证监会颁布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》规定，公司拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的 20%，即不超过 25,870,000 股（含 25,870,000 股）。

最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，按照相关规定，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商），根据中国证监会核准的发行数量上限及发行对象申购报价的情况协商确定。

公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。若中国证监会等监管部门对前述发行数量有所调整，以其核准的数据为准。

5、华立集团或其指定的控制的企业认购公司本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让，其余发行对象认购公司本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。发行对象所认购股份因发行人分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次非公开发行所获得的发行人股份在锁定期届满后减持时，需遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及发行人公司章程的相关规定。

6、本次非公开发行募集资金金额不超过 65,000 万元（含 65,000 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额
1	年产 650 万平米高频高速覆铜板青山湖制造基地二期项目	59,748.00	46,000.00
2	补充流动资金	19,000.00	19,000.00
合计		78,748.00	65,000.00

本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投资额，则不足部分由公司通过自筹方式解决。

7、公司控股股东华立集团或其指定的控制的企业将以现金方式认购本次非公开发行的股份，拟认购股份数量不超过本次非公开发行股份数量的10%。该行为构成关联交易，需经公司股东大会审议批准，华立集团作为关联股东将在股东大会对相关事项予以回避表决。

8、本次非公开发行完成后，公司的控股股东及实际控制人不会发生变化，本公司的股权分布符合上海证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

9、根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）的相关要求，公司制定了《浙江华正新材料股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》，进一步完善了利润分配政策，2016年至2018年公司以现金方式累计分配的利润总额为5,840.55万元，占最近三年实现的年均可分配利润7,307.57万元的比例为69.13%。关于公司利润分配政策及最近三年分红等情况请参见本预案之“第六节 公司股利分配政策及执行情况”。

10、根据中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的规定，本公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析并制定了填补回报的具体措施，相关情况详见本预案之“第七节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施”相关内容。制定的填补回报的具体措施不等于对公司未来利润作出保证。

11、本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

12、本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享公司本次发行前滚存的未分配利润。

目 录

发行人声明	2
重大事项提示	3
释义	9
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	12
一、公司基本情况	12
二、本次非公开发行股票的背景和目的	12
三、发行对象及其与公司的关系	15
四、本次非公开发行方案概要	16
五、募集资金投资项目	18
六、本次发行是否构成关联交易	19
七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	19
八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序	19
第二节 发行对象基本情况	20
一、华立集团基本情况	20
二、华立集团及其董事、监事、高级管理人员最近五年受处罚及诉讼或仲裁情况	21
三、本次发行后同业竞争和关联交易情况	22
四、本预案披露前 24 个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况	22
第三节 附生效条件的股份认购合同摘要	23
一、协议主体、签订时间	23
二、认购价格、认购数量、认购方式和支付方式	23
三、锁定期	25
四、合同生效条件	25
五、违约责任	25
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	27
一、本次募集资金使用计划	27

二、本次募集资金使用的可行性分析	27
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响	36
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	37
一、本次发行对公司业务结构、章程、股东结构、高管人员结构的影响	37
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力和现金流量的变动情况	38
三、本次发行对公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争的影响	39
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形	40
五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	40
六、本次股票发行相关的风险说明	40
第六节 公司利润分配政策及执行情况	43
一、公司现行利润分配政策	43
二、最近三年公司利润分配情况	45
三、未来三年股东回报规划	45
第七节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施	47
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	47
二、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示	50
三、本次非公开发行股票的必要性和合理性	50
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	50
五、本次非公开发行摊薄即期回报填补的具体措施	52
六、关于确保公司本次非公开发行填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的相关承诺	53

释义

除非另有所指，本预案出现的专用术语和简称遵照本释义的解释：

基本术语		
发行人/公司/本公司/上市公司/华正新材	指	浙江华正新材料股份有限公司，本次非公开发行的发行人
华立集团	指	华立集团股份有限公司，上市公司控股股东
立成实业	指	浙江立成实业有限公司，华立集团股份有限公司的控股股东
华立医药	指	华立医药集团有限公司
发行、本次发行、本次非公开发行	指	浙江华正新材料股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票的行为
本预案	指	浙江华正新材料股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案
定价基准日	指	本次非公开发行的发行期首日
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
专业术语		
覆铜板	指	覆铜箔层压板的简称，英文简称“CCL”（Copper Clad Laminate），是将增强材料浸以树脂，一面或两面覆以铜箔，经热压而成的一种板状材料，用于制作印制电路板，是一类特殊的层压树脂基复合材料
IDC	指	互联网数据中心
5G	指	第五代移动通信网络
物联网	指	Internet of Things，简称 IoT，是互联网、传统电信网等信息承载体，让所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络。
玻纤布、玻璃纤维布	指	作为 FR-4 覆铜板的纤维增强材料，具有优良的耐热性、机械强度和电气绝缘性等性能
印刷电路板、PCB	指	印制电路板，英文简称“PCB”（Printed Circuit Board），以覆铜板为基材，其上附有导电图形，并布有孔（如元件孔、紧固孔、金属化孔等），用来代替以往装置电子元器件的底盘，并实现电子元器件之间的相互连接和支撑
FR-4	指	一种阻燃复合材料等级的代号，所代表的复合材料

		在引燃后必须能够自行熄灭，该复合材料由环氧树脂和玻纤布构成
CEM-3	指	以环氧树脂玻纤布基粘结片为面料，以环氧树脂玻璃毡基粘结片为芯料的覆铜板
HDI	指	High Density Interconnect 的缩写，即“高密度互连”，一种采用细线路、微小孔、薄介电层的高密度印刷线路板技术
环氧树脂	指	凡分子结构中含有环氧基团的高分子化合物统称环氧树脂。
无铅板、无卤板	指	无铅板指适应 PCB 无铅制程的高耐热覆铜板；无卤板指低卤族元素含量的环保型覆铜板
TG	指	玻璃态转化温度，Glass Transition Temperature 的缩写。是玻璃态物质在玻璃态和高弹态之间相互转化的温度。一般 TG 的板材为 130 度以上，高 TG 一般大于 170 度，中等 TG 大于 150 度。TG 值越高，板材的耐温度性能越好，尤其在无铅制程中，高 TG 应用比较多。
Prismark	指	印刷电路板及其相关领域知名的市场分析机构，其发布的数据在 PCB 行业有较大影响力。
DK/介电常数	指	介电常数，Dielectric Constant 的缩写，是电极间充以某种物质时的电容与同样构造的真空电容器的电容之比，通常表示某种材料储存电能能力的大小。当 Dk 大时，表示储存电能能力大，电路中信号传输速度就会变慢；Dk 小时，表示储存能力小，传输速度快
DF/介质损耗	指	介质损耗，Dielectric Loss Factor 的缩写。绝缘材料或电介质在交变电场中，由于介质电导和介质极化的滞后效应，使电介质内流过的电流相量和电压相量之间产生一定的相位差，即形成一定的相角，此相角的正切值即介质损耗。DF 越高，介质电导和介质极化滞后效应越明显，电能损耗或信号损失越多
PTFE	指	聚四氟乙烯（Poly tetra fluoroethylene，简称为 PTFE），一般称作“不粘涂层”或“易清洁物料”，具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂、耐高温、摩擦系数极低的特点。
PPE	指	聚丙烯，通常商业上提供的 PPE 材料一般都混入了其他热塑性材料例如 PS（苯乙烯）、PA（聚酰胺，俗称尼龙）等材料的复合材料，加工成型后具有良好的几何稳定性、化学稳定性，电绝缘性和低热膨胀系数。
碳氢化物树脂	指	又称石油树脂，是石油裂解所副产的 C5、C9 馏份，经前处理、馏分，聚合、压滤，蒸馏等工艺生产的一种热塑性树脂，是分子量介于 300-3000 的低聚物。

LED	指	发光二极管，Light Emitting Diode 的缩写，其应用可分为 LED 单管应用（包括背光源 LED、红外线 LED 等）以及 LED 显示屏等
IC	指	Intergrated Circuit 的缩写，集成电路

注：本预案中任何涉及总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要

一、公司基本情况

中文名称	浙江华正新材料股份有限公司
英文名称	Zhejiang Wazam New Materials CO., LTD.
法定代表人	刘涛
注册地址	浙江省杭州市余杭区余杭镇华一路 2 号
注册资本	129,350,000 元
成立日期	2003 年 3 月 6 日
股份公司设立日期	2010 年 10 月 29 日
上市日期	2017 年 1 月 3 日
股票上市地	上海证券交易所
邮政编码	311121
电话	0571-88650709
传真	0571-88650196
网址	www.wazam.com.cn
经营范围	复合材料、电子绝缘材料、覆铜板材料的生产、销售、技术开发及技术服务，经营进出口业务，自有房屋租赁。

二、本次非公开发行股票的背景和目的

（一）本次非公开发行股票的背景

覆铜板简称 CCL (Copper Clad Laminate)，是将电子玻璃纤维布或其它增强材料浸以树脂，通过烘干、裁剪、叠合成坯料，一面或双面覆以铜箔并经热压而制成的一种板状材料，主要用于制作印制电路板 (PCB)，对 PCB 起互联导通、绝缘和支撑的作用，是电子行业最上游、最基础的产品。

1、政策助推覆铜板行业发展，中国覆铜板产值市值第一

自上世纪八十年代至今，在改革开放战略及产业政策扶持下，中国覆铜板工业得到了高速发展。中国作为全球 PCB 制造中心地位的持续提升，并已经成为

全球覆铜板制造业最大的生产基地。中国的覆铜板产业对世界电子工业的影响举足轻重，覆铜板产量稳居世界第一。

中国的覆铜板工业之所以取得如此巨大的发展，从一个 CCL 生产小国成长为全球第一，其原因可以归纳为：其一、全球化的大趋势；其二、中国加入 WTO；其三、社会经济的变革使劳动力从农业向工业化转移，农业生产水平水平的提高使得剩余劳动力转移到人均生产力更高的制造业和服务业，为制造业提供充足的人口“红利”；其四、中国政府实施了正确的符合国情的政策；其五、高效完整的产业链和供应链网络形成；其六、企业在充分竞争中健康成长；其七、形成了种类齐全和多层次的产品结构以及资本背景多元化的企业群。

随着世界电子信息产业新技术、新产品的不断发展，覆铜板行业正面临新一轮的挑战和机遇，特别是新技术、新产品的创新和运用带来了新的发展机会。为了能够把握行业发展带来的机遇，规避被行业淘汰的风险，企业应当加强产品研发，推陈出新不断提高产品性能，优化产品结构，并紧跟市场动向，保持、提高自身核心竞争力。

2、中高端覆铜板产品稀缺，正值进口替代黄金时期

虽然在产量方面，中国较美、欧、日等国家具有领先优势，但从产品附加值来看，中国覆铜板主要为中低端产品，附加值低，技术含量逊色于美、欧、日等发达国家。通讯及 IDC 需求的高频高速板材技术仍掌握在美国、日本企业手中。

国内高技术、高附加值 CCL 品种则相对稀缺。根据海关总署披露的 CCL 进出口价格数据，我国 CCL 出口价长期低于进口价，并且近年来两者之间的差距不断拉大。2018 年，我国覆铜板出口量依然超过进口量，但出口总额低于进口总额，总体贸易逆差 5.21 亿美元，说明进口产品附加值更高，国内该品类供应稀缺。

随着中国大陆覆铜板企业的不断发展，包括华正新材在内的 CCL 企业，长期专注于高频高速覆铜板的研发和生产，加速突破多种材料路线。在高频高速覆铜板领域，华正新材自主研发的产品已通过国内知名大型通讯公司的技术认证，

公司技术已得到认可。随着政策扶持力度不断加大，CCL 行业正值高端化突破的黄金时期，进口替代空间大。

3、5G、物联网带来新需求的同时，也带来了更高的要求

“5G”、“物联网”、“智能制造”等概念的提出，推动了汽车电子、人工智能、半导体及电子产业等下游行业的发展。覆铜板和 PCB 的应用领域不断拓展，下游客户对该类产品的需求也不断提高。

行业发展带来新的需求的同时，对产品的性能也提出了更高的要求。移动终端性能的不断提升，将使得电子部件开始向着高集成度、高速高频化方向发展，传统的覆铜板因为其较高的介质损耗因子等因素难以满足如今的需求。这将使得作为支撑体的覆铜板必须更新升级，中高端覆铜板产品需求迫切。

在此背景下，公司不断加大研发并与下游应用行业积极开展合作，生产出了符合下游需求、性能更加优异稳定的高频高速覆铜板等产品。本次非公开募集资金，将主要用于提高高频高速覆铜板的产量，加速对高频高速等高等级覆铜板产品的进口替代，进一步推动我国半导体及电子产业国产化进程。

（二）本次非公开发行股票的目的

1、推动覆铜板产品升级迭代

近年来公司为适应市场需求，将低介电损耗、高可靠性、高速用基材列为重要的研究方向。针对不同的应用领域，对公司现有树脂体系进行全面的升级，研究开发了品种丰富、性能优异稳定的高频高速基材产品系列。经过前期与终端客户的合作开发，其中多款通讯用高频高速覆铜板已通过国内终端通讯公司的技术认证，并进入其材料库，公司已具备批量供货资格和能力。

2、扩大高频高速覆铜板产能

作为国内覆铜板行业的领先企业，公司凭借独特的技术优势与优异的产品质量已获得业界的认可，具备较强的产品竞争优势。在市场空间日益扩大的背景下，虽然公司工艺技术和产品性能得到了广泛认可，但是受限于产能瓶颈，尤其是公司积极研发的广泛应用于“5G”、“物联网”等行业的高频高速等高等级覆铜板

产品产能无法满足未来高速增长的终端需求，严重阻碍了公司市场占有率的有效提升。因此，公司急需进一步扩大产能，以满足市场持续增长需求，维持并扩大公司市场占有率与品牌影响力，巩固行业地位。

本次募集资金到位后，公司将凭借强大的研发能力，紧跟市场前沿，快速推出适应市场发展需求的产品。背靠稳定的销售团队和良好的市场基础，公司将进一步提高自主创新能力、优化产品结构、推进产业结构升级、提高市场竞争能力，依靠自身的努力和国家的政策扶持，实现企业总体发展战略。

3、补充流动资金，优化财务结构

按照公司发展规划，未来公司将致力于高频高速高等级覆铜板产品的研发生产，在丰富产品结构、扩展营销渠道和加大研发力度等方面均需要投入大量资金。单纯依靠债务融资，将使公司在未来较长的时期内面临沉重的财务负担。公司拟通过本次非公开发行，募集资金补充公司流动资金，优化公司财务结构，为技术研发和业务发展提供资金支持，为后续业务的持续发展、保持行业领先地位奠定良好的基础。

4、增强公司的可持续发展能力

公司拟通过本次非公开发行募集资金，进一步提高公司资产规模、股东权益和净利润，同时公司的综合竞争能力、市场拓展能力、抗风险能力和持续发展能力也将进一步增强，从而保护上市公司及其股东特别是中小股东的利益。

三、发行对象及其与公司的关系

本次发行对象为包括公司控股股东华立集团或其指定的控制的企业在内的不超过 10 名特定对象。

华立集团或其指定的控制的企业承诺以现金认购公司本次非公开发行的股份，认购股份数量不超过本次非公开发行股份数量的 10%。本次非公开发行完成后，本公司的实际控制人及控股股东将不会发生变化。

除华立集团或其指定的控制的企业外，本次非公开发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机

构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，按照相关法律法规的规定及监管机构要求，根据发行对象申购情况及竞价结果，由发行人董事会根据股东大会的授权与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

所有发行对象均以现金方式一次性认购。

四、本次非公开发行方案概要

（一）发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。

（二）发行方式

本次发行采取非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准之日起的六个月内择机发行。

（三）定价基准日、发行价格和定价原则

本次非公开发行股票定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。

本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会在股东大会授权范围内、与保荐机构（主承销商）协商，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。

（四）发行对象及认购方式

本次发行对象为包括公司控股股东华立集团或其指定的控制的企业在内的不超过 10 名特定对象。除华立集团或其指定的控制的企业外的发行对象为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式一次性认购。

（五）发行数量

本次非公开发行的发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 20%，即不超过 25,870,000 股（含 25,870,000 股），在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。其中，控股股东华立集团或其指定的控制的企业拟认购股份数量不超过本次非公开发行股份数量的 10%。

若公司股票在本次非公开发行的董事会决议日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的发行数量将相应调整。

本次非公开发行股票的最最终发行数量将由公司股东大会授权董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据经中国证监会核准的发行方案及发行时的实际情况协商确定。

（六）限售期

根据《管理办法》及《实施细则》的相关规定，本次非公开发行完成后，华立集团或其指定的控制的企业认购公司本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让，其余特定投资者认购公司本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。发行对象所认购股份因发行人分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次非公开发行所获得的发行人股份在锁定期届满后减持

时，需遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及发行人公司章程的相关规定。

（七）上市地点

本次非公开发行的A股股票将在上海证券交易所上市交易。

（八）本次非公开发行前的滚存利润安排

本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共享。

（九）本次非公开发行决议的有效期限

本次非公开发行股票决议的有效期限为股东大会审议通过之日起12个月。

五、募集资金投资项目

本次非公开发行募集资金总额不超过65,000万元（含65,000万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额
1	年产650万平米高频高速覆铜板青山湖制造基地二期项目	59,748.00	46,000.00
2	补充流动资金	19,000.00	19,000.00
合计		78,748.00	65,000.00

若本次非公开发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

六、本次发行是否构成关联交易

华立集团或其指定的控制的企业认购公司本次非公开发行股份构成关联交易，需报经公司股东大会审议批准。相关议案提交股东大会审议时，关联股东将进行回避表决。

七、本次发行是否导致公司控制权发生变化

本次发行前，华立集团直接持有公司 43.01%的股份，为公司控股股东；汪力成先生直接持有华立集团 5.82%的股份并通过其全资企业立成实业间接持有华立集团 48.52%的股份，为公司的实际控制人。

本次非公开发行股票不超过 25,870,000 股（含 25,870,000 股），若本次非公开发行按发行数量的上限实施，本次发行完成后公司总股本为 155,220,000 股；若华立集团参与认购，且认购本次非公开发行股数的 10%，则在本次发行后，华立集团持股比例约为 37.51%，仍为公司控股股东，汪力成先生亦仍为公司的实际控制人；若华立集团控制的企业参与认购，且认购本次非公开发行股数的 10%，则在本次发行后，华立集团持股比例约为 35.84%，其控制的企业持有公司 1.67% 的股份，华立集团仍为本公司的控股股东，汪力成先生亦仍为公司的实际控制人。

综上，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序

本次非公开发行 A 股股票已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。本次非公开发行尚需履行以下程序后方可实施：

- 1、公司股东大会审议批准本次非公开发行；
- 2、本次非公开发行取得中国证监会核准；
- 3、其他监管部门的批准或核准（如需）。

第二节 发行对象基本情况

本次非公开发行的发行对象为包括控股股东华立集团或其指定的控制的企业在内的不超过10名（含10名）特定投资者。除控股股东华立集团或其指定的控制的企业外的其他发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合格投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

截至本预案公告之日，除华立集团或其指定的控制的企业外的其余投资者尚未确定。华立集团及其控制的企业的基本情况如下：

一、华立集团基本情况

（一）基本信息

公司名称：华立集团股份有限公司

成立日期：1999年6月6日

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常大道181号

法定代表人：裴蓉

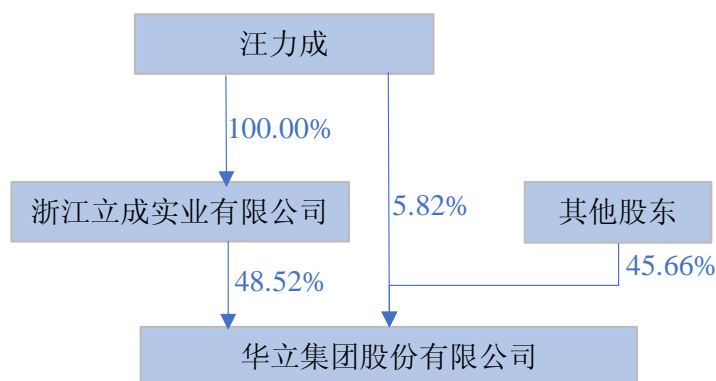
注册资本：30,338万元人民币

统一社会信用代码：913300007042069982

（二）股权控制关系

截至本预案公告之日，立成实业持有华立集团48.52%的股份，是华立集团的控股股东。汪力成先生直接持有华立集团5.82%的股份并通过其全资企业立成实业间接持有华立集团48.52%的股份，为华立集团的实际控制人。

华立集团的股权控制关系如下图所示：



（三）主营业务发展情况

华立集团是以实业投资、贸易为主的投资控股型公司，控制的下属企业主要涉及医药、智能电网、新材料、新能源等产业。

（四）最近一年简要财务报表

单位：亿元

项目	2018年12月31日
资产总额	187.48
负债总额	123.16
所有者权益	64.32
归属于母公司的所有者权益	20.06
项目	2018年度
营业收入	253.32
净利润	5.80
归属于母公司的净利润	2.35

注：上述数据未经审计。

二、华立集团及其董事、监事、高级管理人员最近五年受处罚及诉讼或仲裁情况

截至本预案公告之日，华立集团及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

三、本次发行后同业竞争和关联交易情况

本次发行后，公司与华立集团或其指定的控制的企业之间不存在新增同业竞争的情况。华立集团将持续履行上市公司首次公开发行时出具的解决同业竞争承诺。

公司对现有的关联方、关联关系、关联交易已作了充分披露，关联交易均出于经营、发展需要，系根据实际情况依照市场公平原则进行的等价有偿行为，价格公允，没有背离可比较的市场价格，并且履行了必要的程序。关联交易不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

华立集团或其指定的控制的企业拟认购公司本次非公开发行A股股票，构成与公司的关联交易。公司就此按照法律法规等相关规定履行关联交易程序。除此之外，公司与华立集团或其指定的控制的企业之间的关联交易不会因本次非公开发行而相应增加。

四、本预案披露前24个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况

本次发行预案披露前24个月内华立集团或其指定的控制的企业与本公司之间的重大关联交易情况已履行相关信息披露。公司的各项关联交易均严格履行了必要的决策和披露程序，符合有关法律法规以及公司制度的规定。详细情况请参阅登载于指定信息披露媒体的有关定期报告及临时公告等信息披露文件。

第三节 附生效条件的股份认购合同摘要

2019年4月26日，公司与华立集团签署了《股份认购协议》，主要内容摘要如下：

一、协议主体、签订时间

- 1、发行方：浙江华正新材料股份有限公司
- 2、认购方：华立集团或其指定的控制的企业
- 3、协议签订时间：2019年4月26日

二、认购价格、认购数量、认购方式和支付方式

（一）认购价格

双方同意，发行方以不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十且不低于发行方最近一期未经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产的价格，向认购方发行股份。“交易均价”的计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

若发行方在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过除权、除息调整后的价格计算。若发行方在截至定价基准日最近一期未经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则上述归属于母公司普通股股东每股净资产值将进行相应调整。

本次非公开发行的最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，按照相关法律法规的规定及监管机构要求，由发行人董事会根据股东大会的授权，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）按《实施细则》等相关规定在

上述发行底价的基础上接受市场询价，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。认购方将不参与市场询价过程，但接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。如发行方在董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则本次非公开发行股份的价格将作相应调整。

（二）认购数量

华正新材本次非公开发行的发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即不超过25,870,000股（含25,870,000股），在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。其中，控股股东华立集团或其指定的控制的企业拟认购股份数量不超过本次非公开发行股份数量的10%。

若公司股票在本次非公开发行的董事会决议日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的发行数量将相应调整。

本次非公开发行股票的最最终发行数量将由公司股东大会授权董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据经中国证监会核准的发行方案及发行时的实际情况协商确定。

（三）认购方式和支付方式

认购方承诺以现金方式认购华正新材本次非公开发行的股份。

华立集团股份有限公司或其指定的控制的企业同意在本次非公开发行获中国证监会正式核准后，发行方进行本次非公开发行时，在本合同生效后，按照华正新材和本次发行保荐人发出的《认购及缴款通知书》的要求缴款通知的约定，在该通知确定的缴款日前一次性以现金方式将全部认购价款划入承销商为本次发行专门开立的账户，验资完毕后，扣除相关费用再划入发行人募集资金专项存储账户。

在本次非公开发行完成后，华正新材应及时协助华立集团股份有限公司或其指定的控制的企业完成华立集团股份有限公司或其指定的控制的企业在证券登记结算公司的股份登记事宜。

三、锁定期

认购方承诺，其认购的标的股份的锁定期为 36 个月，自本次非公开发行结束之日起算，在该锁定期内，认购方不得上市交易或以任何方式转让任何标的股份。

认购方因本次非公开发行股份所获得的发行方股份在锁定期届满后减持的，需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及发行方公司章程的相关规定。

四、合同生效条件

本合同经发行方和认购方的法定代表人或授权代表人签署并加盖公章后成立，并在满足下列全部条件后生效：

- (1) 本协议获得发行人董事会审议通过；
- (2) 本协议获得发行人股东大会批准；
- (3) 如需要，发行人股东大会批准认购人免于发出收购要约；
- (4) 中国证监会及其他有权部门核准、批准发行人本次非公开发行股票方案。

如上述条件未获满足，则本协议自动终止。

五、违约责任

任何一方未按本合同之规定履行其义务，因此给有关当事人造成损失者，违约方应赔偿有关当事人的任何及全部损失。

本合同项下约定的非公开发行股票事宜如未获得（1）发行人股东大会通过；或（2）中国证监会核准的；或（3）发行人根据中国证监会要求调整本次发行的发行方案的，不构成发行人违约。

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划

本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过65,000万元人民币，扣除发行费用后将投资于“年产650万平米高频高速覆铜板青山湖制造基地二期项目”、“补充流动资金”，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额
1	年产650万平米高频高速覆铜板青山湖制造基地二期项目	59,748.00	46,000.00
2	补充流动资金	19,000.00	19,000.00
合计		78,748.00	65,000.00

若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额、优先顺序进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入上述项目，并在募集资金到位后按照相关法律法规予以置换。

二、本次募集资金使用的可行性分析

（一）年产650万平米高频高速覆铜板青山湖制造基地二期项目

1、项目基本情况

2018年全球PCB总产值624亿美元，同比增长6%，预计未来几年，在细分行业结构性增长带动下，覆铜板市场规模将保持稳健增长。覆铜板行业工艺及资金壁垒高，全球竞争格局稳定，中高端基板为海外垄断，中国大陆覆铜板整体附加值较低，正值高端化突破黄金时期，进口替代空间大。

华正新材作为我国覆铜板行业领先公司，为顺应行业发展以及5G时代带来的需求增加，拟通过引进国内外先进的生产设备、配套性能优异的检测设备等，在浙江省杭州市青山湖园区内，建设高频、高速覆铜板的生产基地。项目达产后，将形成年产650万平方米高频、高速覆铜板的产能，满足高频通信对于覆铜板材料提出的新需求。本项目的实施，顺应了5G、物联网发展的新趋势。

2、项目建设的背景和必要性

(1) 覆铜板行业稳健成长，但高附加值产品稀缺，正值进口替代黄金时期

覆铜板（Copper Clad Laminate），简称CCL，是由石油木浆纸或者玻璃纤维布等作增强材料，浸以树脂，单面或者双面覆以铜箔，经热压而成的一种板状材料。覆铜板上游原材料主要包括铜箔、玻璃纤维布、树脂等材料。

按照机械性能分类，覆铜板可分为刚性覆铜板和挠性覆铜板。刚性CCL是指不易弯曲，并具有一定硬度和韧度的覆铜板；挠性CCL是用具有可挠性补强材料（薄膜）覆以电解铜箔或压延铜箔制成，其优点是可以弯曲，便于电器部件的组装。

全球覆铜板行业已形成多极化发展阶段，美、欧、中、日、台、韩企业在不同档次产品市场上的份额分割存在较大差异，中、台、韩的内资CCL企业覆铜板产品以中、低端产品为主，以规模及成本优势侵蚀日、美、欧同行的中低端产品市场份额，但高端覆铜板市场仍由日、欧、美企业占据。

中国为全球CCL最大市场，但是主要为中低端产品。根据Prismark公司发布的数据，2018年全球PCB总产值624亿美元，同比增长6%，其中，中国大陆总产值327亿美元，全球第一，同比增长10%。然而，中国目前的覆铜板产品仍主要为中低端产品，通讯及IDC需求的高频高速板材技术仍掌握在美国、日本及欧洲企业手中。国内高技术、高附加值CCL品种则相对稀缺，根据海关总署披露的CCL进出口价格数据，我国CCL出口价长期低于进口价，并且近年来两者之间的差距不断拉大。

从我国大陆地区覆铜板进出口数据来看，2018年我国覆铜板出口量依然超过进口量，但出口总额低于进口总额，总体贸易逆差5.21亿美元，说明进口产品附加值更高，国内该品类供应稀缺。

近年来我国大陆地区覆铜板进出口数据如下：

单位：万美元、吨

时间	出口数量	出口金额	进口数量	进口金额	贸易逆差
2013	131,993.68	76,917.79	103,457.32	113,873.22	36,955.42
2014	127,127.39	73,317.04	96,876.68	117,108.55	43,791.50
2015	112,151.01	62,471.44	83,237.60	101,006.38	38,534.94
2016	102,650.14	53,546.80	78,850.81	97,032.88	43,486.08
2017	94,338.60	59,575.99	85,363.68	109,821.20	50,245.20
2018	93,826.67	59,418.45	79,486.43	111,479.14	52,060.69

随着中国大陆覆铜板企业的不断发展，包括华正新材在内的CCL企业，长期专注于高频高速覆铜板的研发和生产，加速突破多种材料路线，CCL行业正值高端化突破黄金时期，进口替代空间大。

(2) 高频高速是覆铜板技术的发展方向所在

5G、物联网概念的兴起，推动电子设备性能不断提升，并且向着高集成度、高速高频化方向发展，这使得作为支撑体的PCB及覆铜板必须更新升级，中高端覆铜板产品需求迫切。此外，在环保要求不断提升以及PCB下游应用持续升级的背景下，覆铜板呈现出无卤化型、高TG型、高频型、高速型、封装基板用和高导热型等发展趋势。

根据Prismark统计，目前覆铜板应用最广泛的仍然是传统环氧树脂玻璃纤维板（FR-4）产品，但已经进入高度成熟、逐步萎缩的阶段；高频高速覆铜板产品将逐步进入爆发式发展阶段，在未来覆铜板市场中占有比例将逐步接近FR-4。

高速和高频是在玻璃纤维布基覆铜板的基础上，通过使用不同类型的树脂实现的，其核心要求是低介电常数（Dk）和低介电损耗因子（Df）：介电常数（Dk）越小越稳定，高频高速性能越优；介质损耗（Df）越小越稳定，高频高速性能越优。一般而言，降低Dk和Df主要通过树脂材料、基板材料及基板树脂含量来

实现。各种树脂类型按照 Df 由大到小，依次包括环氧树脂、特殊树脂/改性特殊树脂、PTFE/碳氢化物树脂/PPE 树脂。目前 PCB 中广泛使用的大多为环氧树脂玻璃布基 CCL (FR-4)，其 Df 值在 0.01 以上。而 PTFE 和碳氢化合物树脂 Df 值在 0.002 以下，是高频材料的两种主流形式，高速材料所用树脂的 Df、Dk 介于高频材料和 FR-4 之间，随着材料的不断优化改进，其损耗也越来越低。

(3) 5G 时代，高频高速覆铜板需求大幅提升

随着移动互联网、云计算、物联网、5G、航天航空、军事领域等电子技术的日益发展，低频率无线电波日益拥挤，迫使通信传输向更高频率发展，高频高速覆铜板材料的需求增长迅速。

高速材料与高频材料一样，一方面可以应用于物联网、5G 等新兴领域，另一方面，也可以替代传统的 FR-4 覆铜板。未来几年，在 5G、汽车自动驾驶、物联网等行业带动下，高频高速等高端覆铜板市场需求将迅速扩大，发展前景良好。

5G 基站建设数量大幅增加，带动高频高速基材发展。未来 5G 移动通信将不再依赖大型基站的布建架构，而是使用大量的小型基站实现密集覆盖。根据工信部数据，截至 2018 年我国 4G 基站数量约 372 万个。预计我国 5G 宏基站密度将是 4G 基站的 1.5 倍，总数或将达到 450-500 万个。全球小基站数量则更多，ABI Research 研究数据表明，目前全球的小基站数量不到 300 万个（不含宏基站），到 2020 年将突破 870 万个。5G 基站建设数量的提升将带动基站功放和天线市场规模的快速增长，低损耗及超低损耗高频覆铜板需求随之增加，同时，高速覆铜板的市场需求也将受益于基站建设数量的增加。

同时，5G 基站结构的变化也将大幅增加对高频高速基材的需求。在基站结构方面，由 4G 时代的 BBU+RRU，升级为 DU+CU+AAU 三级结构。传统 4G 基站中，主要是 RRU 中的功率放大器部分采用的高频覆铜板，其余大部分采用的是 FR-4 覆铜板；5G 模式下，RRU 和天线集成为 AAU，频段上升带动高频材料增加，未来将改用 FR4 和高速材料混压或者纯高速材料。因此，由于 5G 传输数据量大幅增加、对射频要求更高，将采用更多的高频高速覆铜板。

总体而言，受益于5G发展，高频高速覆铜板的需求将大幅提升。

(4) 公司高频高速覆铜板产能瓶颈亟待解决

作为国内覆铜板行业的领先企业，公司凭借独特的技术优势与优异的产品质量已获得业界的认可，具备较强的产品竞争优势。在市场空间日益扩大的背景下，虽然公司工艺技术和产品性能得到了广泛认可，但是受限于产能瓶颈，尤其是公司积极研发的广泛应用于“5G”、“物联网”等行业的高频高速等高等级覆铜板产品产能无法满足未来高速增长终端需求，阻碍了公司市场占有率的有效提升。因此，公司需进一步扩大产能，以满足市场持续增长的需求，维持并扩大公司市场占有率与品牌影响力，巩固行业地位。

本项目建成投产后，公司将凭借强大的研发能力，紧跟市场前沿，加速推出适应市场发展需求的产品，背靠稳定的销售团队和良好的市场基础，推进产业结构升级、提高市场竞争能力，依靠自身的努力和国家的政策扶持，实现企业总体发展战略。

3、项目建设的可行性

(1) 项目建设符合国家产业政策和规划

2008年，国家关税税则委员会为覆铜板单列了关税税号，将覆铜板产业定为“电子类”国家鼓励发展的产业。此后，相关政府部门陆续出台了《关于提高轻纺电子信息等商品出口退税率的通知》（财税[2009]43号）、《关于进一步做好电子信息产业振兴和技术改造项目组织工作的通知》（发改办高技[2009]1817号）、《电子信息制造业“十二五”发展规划》、《中国制造2025》、《关于积极推进“互联网”行动的指导意见》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等一系列的政策，提出要重点支持高密度互连多层印制电路板、IC封装基板、特种印制电路板及相应环保型的高性能覆铜板、导热覆铜板等研发和产业化，并于2009年4月1日将覆铜板出口退税率提高至17%。

各项产业政策的陆续出台，彰显了国家促进高精尖半导体领域发展创新、鼓励扩大覆铜板产能、最终实现半导体及电子产业国产化的信念和决心，为覆铜板

行业的健康发展提供了良好的政策环境，同时也对行业内的参与者提出了更高的标准和要求。

(2) 下游市场广阔为项目建设提供有力保障

最近几年，随着电子信息行业的逐步复苏并步入正轨，覆铜板市场需求稳定增长，在平板电脑、智能手机等以高密度、高集成为特征的高端电子产品以及LED节能产业发展的推动下，金属基板、高导热CEM-3、HDI用覆铜板、高频、高速用覆铜板等高性能覆铜板发展更加迅速。

随着“中国制造2025”、“强基工程”和“互联网+”等重大产业转型升级战略的推进，我国电子信息产业将保持持续较快增长。作为重要的基础材料，覆铜板的下游应用将更加广阔。

预计2018-2025年高频高速基材需求将保持持续高速增长（包含车载毫米波雷达、物联网、5G基站天线等应用领域），且其市场需求增长节奏确立：①5G商用前夜，汽车辅助驾驶系统的渗透带动汽车雷达出货量提升，将持续推动低损耗及超低损耗高频电路基材需求；②2019年国内及全球5G建设投资周期拉开后，高频高速基材主要战场将转变为5G通信基站天线应用，数百亿市场需求有望伴随国内5G建设周期迎来渐进式爆发增长；③5G商用将真正开启万物互联，全球消费电子及可预见的5G无线连接物联网设备持续带来高频材料需求。市场需求的增长将为公司高频高速覆铜板项目建设提供可靠的保障。

(3) 公司具备项目实施的各项条件

公司技术积累深厚，有望抓住5G战略机遇，成长为国内高频高速覆铜板的核心供应商。在研发力量方面，公司依托浙江省企业技术中心和浙江省高新技术企业研究开发中心，建立了一支专业范围涵盖电工电子、化学化工、材料、机械、物理等学科在内的高端研发团队，主要核心技术人员均拥有超过10年的从业经验。在研发成果方面，公司自主开发完成了多项专利及专有技术，截至目前拥有发明专利54项，实用新型专利77项。

作为国内专业从覆铜箔板的领先企业，公司已经具备实施本次项目所需的研发实力、管理经验、营销渠道和人才储备等必要条件。

在设备方面，公司将引进国际先进设备，构建产能、性能达到国际领先水平的高端覆铜板生产线，以保证公司生产的高频高速覆铜板在品质上具有较强的市场竞争力。

在工艺方面，公司在高频高速覆铜板领域工艺成熟。高频覆铜板层面，公司已具备 H5220、H5255、H5265、H5300 四款玻纤增强型 PTFE 系列基材量产能力，产品介电性能优良，可用于基站天线、雷达系统等领域。高速覆铜板层面，公司生产的 H175HF、H180HF、H185H 等产品已完成开发并初步投入市场。

①射频微波高频覆铜板基材

2018年，公司高频项目 H5 系列产品实现量产，产品已进入重要终端的供应链。为满足未来射频微波领域的市场需求，扩大产品在教育端的市场份额，公司实现了高频产品的技术突破，开发了高频 HC 系列和 HN 系列产品，丰富了 PTFE 系列和碳氢系列的产品种类，以更好的满足未来 5G 通讯、汽车自动驾驶、超高频雷达等领域的需要。

②高速通讯基材

近年来，公司为适应市场需求，将低介电损耗、高可靠性、高速用基材列为重要的研究方向。针对不同的应用领域，对公司现有树脂体系进行全面的升级，研究开发了品种丰富、性能优异稳定的高速基材产品系列。经过前期与终端客户的合作开发，其中一款通讯用高速覆铜板已通过国内知名大型通讯公司的技术认证，并进入其材料库，目前已在批量生产中。另两款可替代美国日本进口材料的高端产品现已开发完成，目前处于客户认证阶段。

在销售方面，经过前期和终端客户的合作开发，公司生产的高频、高速及多层印制电路用覆铜板部分产品已通过部分知名企业的终端技术认证，具备批量供货资格。凭借公司多年从事覆铜板行业累积的经验与客户资源，公司已建立起了覆盖全国各地和海外市场的销售网络，在销售方面做了充分准备。

本项目实施后，公司将继续推进创新，不断突破壁垒，实现对高频高速等高等级覆铜板产品的进口替代，进一步推动我国半导体及电子产业国产化进程。

4、项目投资概算

本项目总投资额 59,748 万元，包含工程费用 50,941 万元、工程建设其他费用 1,070 万元、预备费 2,737 万元以及铺底流动资金 5,000 万元。

本项目具体投资内容构成如下：

序号	投资类别	投资金额（万元）
1	工程费用	50,941
2	工程建设其他费用	1,070
3	预备费	2,737
4	铺底流动资金	5,000
合计		59,748

5、项目预期收益

经测算，本项目正常达产年度，预计年均营业收入为 136,800 万元，净利润为 14,022 万元，项目预期效益良好。

6、项目建设期

本项目建设期为 2 年。

7、项目实施主体

本项目实施主体为发行人全资子公司杭州华正新材料有限公司。

8、项目的用地情况及审批程序

本项目涉及新增用地，截至本预案出具日，公司已和当地国土资源部门签署《土地使用权出让合同》。项目立项、环评等备案、审批手续均在办理过程中。

（二）补充流动资金

1、项目基本情况

为满足公司日常运营资金需要，公司拟将本次非公开发行募集资金19,000.00万元用于补充流动资金。

2、补充流动资金的必要性

（1）满足公司业务发展的需要

近年来公司业务规模持续发展，营业收入逐年递增。公司2016年度、2017年度和2018年度的营业收入分别为124,950.30万元、151,337.23万元及167,763.41万元，年均复合增长率达到10.32%。预计未来几年内公司仍将处于业务快速扩张阶段，市场开拓、日常经营等环节对流动资金的需求也将进一步扩大。因此，本次非公开发行募集资金补充公司流动资金，能有效缓解公司发展的资金压力，有利于增强公司竞争能力，降低经营风险，具有必要性和合理性。

（2）降低公司资产负债率、优化资本结构

截至2019年3月31日，公司合并报表的总资产为227,939.07万元，负债总额为158,260.94万元，资产负债率为69.43%，与同行业公司相比，处于较高水平。同行业可比上市公司的平均资产负债率为42.89%，具体如下：

序号	股票代码	上市公司简称	资产负债率
1	600183	生益科技	47.24%
2	002636	金安国纪	36.23%
平均值			41.73%
华正新材			69.43%

本次募集资金总额到位后，公司资产负债率将大幅下降，将有效优化上市公司资本结构，提升上市公司的融资能力和提高风险抵御能力。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

公司本次非公开发行募集资金将主要用于“年产 650 万平米高频高速覆铜板青山湖制造基地二期项目”，本次募投项目的实施，是公司把握国家在新能源产业和新兴消费电子领域政策支持、顺应新能源行业 and 新兴消费电子领域蓬勃发展市场机遇的重要举措，符合公司进一步优化生产工艺、扩大先进产能、深化业务布局、实现协同发展的战略规划。募集资金投资项目的实施将对公司的经营业务产生积极影响，有利于提高公司的持续盈利能力、抗风险能力和综合竞争力，巩固公司在行业内的领先地位，符合公司及公司全体股东的利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次非公开发行将为公司产能建设和持续发展提供强有力的资金支持。一方面，本次发行完成后，公司净资产规模将得以提高，有效增强公司的资本实力；同时，公司资产负债率得以降低，有利于优化资本结构，降低财务风险。另一方面，由于新建项目产生效益需要一定的过程和时间，因此每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标在短期内可能出现一定幅度的下降。但是，随着本次募集资金投资项目的有序开展，公司的发展战略将得以有效实施，公司未来的盈利能力、经营业绩将会得到显著提升。

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行对公司业务结构、章程、股东结构、高管人员结构的影响

（一）本次发行对公司业务结构的影响

本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后将用于“年产 650 万平米高频高速覆铜板青山湖制造基地二期项目”、“补充流动资金”。本次发行完成后，公司的主营业务保持不变，募投项目将进一步巩固和加强公司主营业务，增强公司核心竞争力，提升盈利能力，扩大市场份额，塑造良好品牌形象，为未来的持续发展奠定良好基础。因此，本次非公开发行不会对公司主营业务结构产生重大影响，不涉及对公司现有资产的整合，不会对公司的业务及资产产生重大影响。

（二）本次发行对公司章程的影响

本次非公开发行完成后，公司注册资本和股本总额将相应增加，股东结构将发生变化，公司将根据实际发行结果和股本的变化情况，履行《公司章程》修改的相关程序，对《公司章程》中的相关条款进行相应的修改，并办理工商登记手续。

（三）本次发行对股东结构的影响

本次发行前，华立集团直接持有公司 43.01%的股份，为公司控股股东；汪力成先生直接持有华立集团 5.82%的股份并通过其全资企业立成实业间接持有华立集团 48.52%的股份，为公司的实际控制人。

本次非公开发行股票不超过 25,870,000 股（含 25,870,000 股），若本次非公开发行按发行数量的上限实施，本次发行完成后公司总股本为 155,220,000 股；

若华立集团参与认购，且认购本次非公开发行股数的 10%，则在本次发行后，华立集团持股比例约为 37.51%，仍为公司控股股东；汪力成先生亦仍为公司的实际控制人。若华立集团控制的企业参与认购，且认购本次非公开发行股数的 10%，则在本次发行后，华立集团持股比例约为 35.84%，其控制的企业持有公司 1.67% 的股份，仍为本公司的控股股东；汪力成先生亦仍为公司的实际控制人。

本次发行前后，公司主要股东持股比例变化如下表所示：

股东	本次发行前		本次发行后 (华立集团认购)		本次发行后 (华立集团控制的企业 认购)	
	数量(股)	持股比例 (%)	数量(股)	持股比 例(%)	数量(股)	持股比 例(%)
华立集团	55,633,237	43.01	58,220,237	37.51	55,633,237	35.84
华立集团控 制的企业	-	-	-	-	2,587,000	1.67
其他股东	73,716,763	56.99	96,999,763	62.49	96,999,763	62.49
合计	129,350,000	100.00	155,220,000	100.00	155,220,000	100.00

(四) 本次发行对高管人员结构的影响

公司暂无对高管人员进行调整的计划，公司的高管人员结构不会因本次发行而发生变化。

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力和现金流量的变动情况

(一) 本次发行后公司财务状况的变动情况

本次非公开发行完成后，公司的总资产与净资产将同时上升，资产负债率将有所降低，资本实力得以提升，公司整体财务状况将得到进一步改善，抵御财务风险的能力亦将进一步增强。

(二) 本次发行后公司盈利能力的变动情况

本次募集资金拟投资项目的实施将进一步提高公司的市场竞争力，公司规模将增加，营业收入将增长，公司持续盈利能力将进一步提升。由于募投项目建成达产需要一定周期，募集资金使用效益在短期内难以完全体现，但随着募投

项目新增产能逐步释放，相关产品生产能力的显著提升将有利于公司进一步扩大市场占有率，从而有效提高公司的整体盈利能力和竞争能力。

除上述资本性开支以外，本次非公开发行的其他资金将用于补充流动资金，进一步优化公司资本结构，降低财务费用，提高盈利能力。

（三）本次发行后公司现金流量的变动情况

本次发行后，随着募集资金的到位，公司筹资活动产生的现金流入将大幅增加；在资金开始投入募投项目后，投资活动产生的现金流出量将大幅增加；在募投项目完成后，公司经营活动产生的现金流量净额将显著提升；偿还银行借款将使当期筹资活动流出增加，今后偿还利息减少将使筹资活动现金流出减少，有效缓解本公司债务到期偿付的现金流压力。

本次非公开发行有助于改善公司的现金流和财务状况，增强公司抵抗风险能力。

三、本次发行对公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争的影响

本次非公开发行不会影响上市公司生产经营的独立性。本次发行前，华立集团直接持有公司 43.01%的股份，为公司控股股东；汪力成先生直接持有华立集团 5.82%的股份并通过其全资企业立成实业间接持有华立集团 48.52%的股份，为公司的实际控制人。

按照本次非公开发行股数上限、发行金额上限及华立集团或其指定的控制的企业认购数量上限计算，若华立集团参与认购，则在本次发行后，华立集团持股比例约为 37.51%，仍为公司控股股东；汪力成先生亦仍为公司的实际控制人。若华立集团控制的企业参与认购，则在本次发行后，华立集团持股比例约为 35.84%，其控制的企业间接持有公司 1.67%的股份，华立集团仍为本公司的控股股东；汪力成先生亦仍为公司的实际控制人。

本次发行后公司与实际控制人汪力成、控股股东华立集团及其关联人之间的业务关系、管理关系均未发生变化，亦不会因本次发行新增关联交易及同业竞争。

四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

本次非公开发行完成后公司控股股东及实际控制人不会发生变化，公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，亦不存在公司为控股股东、实际控制人及其关联人进行违规担保的情形。

五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况

截至2019年3月31日，公司合并资产负债率为69.43%。本次非公开发行后，不会给公司增加负债（包括或有负债），并且公司资产负债率将有所下降，有利于降低公司的财务风险，优化公司财务结构，进一步加强抗风险能力，增强公司的持续经营能力。

六、本次股票发行相关的风险说明

（一）市场波动风险

覆铜板和树脂基复合材料的终端市场包括计算机、通信、消费电子、电工电气、仪器仪表、交通物流、航天军工等终端市场，由于应用领域广泛，行业整体发展与宏观经济走势以及终端市场如5G商用建设进度相关。

最近几年，全球经济波动较大，对行业整体也产生了一定的影响。因此，公司整体上仍面临较大的市场波动风险。

（二）市场竞争风险

覆铜板行业集中度高，中国覆铜板产业已完全国际化。总体上而言，外资企业规模较大，市场竞争力较强，在高端覆铜板市场的占有率较高；内资企业产品档次相对较低，市场竞争激烈。

树脂基复合材料则具有多品种、小批量、多功能、结构功能一体化等特性，加之应用领域广泛，行业内企业普遍规模较小、数量众多，形成规模化经营效应的难度较大，如竞争加剧，将导致行业整体盈利能力下降。

同时，5G时代的来临在带来机遇的同时也带来了新的竞争点。公司能否在激烈的市场竞争中持续提高市场地位存在一定的不确定性，面临一定的市场竞争风险。

（三）原材料价格波动风险

铜箔、玻纤布及树脂是公司主要原材料，作为大宗交易商品，受国际金融市场波动、宏观经济形势复杂、全球能源供应格局的变化影响，上述原材料的价格波动较大。

原材料采购价格的变化是影响公司产品毛利率的重要因素。如果未来主要原材料市场价格出现剧烈变化，将对公司的成本控制和盈利能力产生不利影响。

（四）汇率波动风险

公司销售收入中，海外市场销售占有较大比例。由于公司出口业务主要以美元或港币结算，在人民币汇率升值的情况下，将会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

目前，国际金融形势较为复杂，影响人民币汇率走势的因素众多，不排除未来人民币汇率出现波动导致公司产生较大汇率损失的情况发生。

（五）审批风险

本次非公开发行方案需经公司股东大会审议批准，存在无法获得公司股东大会表决通过的可能。本次非公开发行尚需取得中国证监会的核准，能否取得相关主管部门的批准或核准，以及最终取得相关主管部门批准或核准的时间存在不确定性。

（六）发行风险

本次非公开发行股票数量、拟募集资金量较大，发行方式为向包括华立集团或其指定的控制的企业在内的不超过 10 名投资者非公开发行。本次非公开发行 A 股股票的发行结果将受到证券市场整体情况、公司所处行业发展情况、公司股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素的影响。因此，本次非公开发行 A 股股票存在募集资金不足、发行失败等发行风险。

第六节 公司利润分配政策及执行情况

一、公司现行利润分配政策

公司现行有效的《公司章程》对税后利润分配政策规定如下：

“第一百五十五条 公司利润分配政策为：

(1) 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性、稳定性和合理性并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

(2) 公司的利润分配方案由董事会根据公司业务发展情况、经营业绩情况拟定并提请股东大会审议批准。公司可以采取现金或股票等方式分配利润；公司一般按照年度进行利润分配，在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红方式分配利润；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

公司进行利润分配时，董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

(3) 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十；公司在确定现金分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和

投资活动的影响以及公司现金存量情况，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益，独立董事应当发表明确意见；公司股东大会对现金方式分配利润具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和要求。

(4) 如以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润且董事会认为以股票方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司以股票方式分配利润；采用股票方式进行利润分配的，应当考虑公司的成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

(5) 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

(6) 公司董事会未作出现金股利分配预案的，应当在年度报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

(7) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(8) 公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况；对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确有必要对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更的，需事先征求独立董事及监事会意见，经过详细论证后，由公司董事会审议并提请股东大会批准；股东大会在审议该项议案时，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过；调整或变更后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定。”

二、最近三年公司利润分配情况

公司 2016 年、2017 年和 2018 年的利润分配方案如下：

单位：万元

分红所属年度	实施分红方案	现金分红金额（含税）	公司归属于母公司所有者的净利润	现金分红占当年净利润的比例
2018 年	每 10 股派 1.5 元(含税)	1,940.25	7,508.03	25.84%
2017 年	每 10 股派 1.5 元(含税)	1,960.05	9,359.78	20.94%
2016 年	每 10 股派 1.5 元(含税)	1,940.25	8,479.45	22.88%

公司 2016 年至 2018 年以现金方式累计分配的利润总额为 5,840.55 万元，占最近三年实现的年均可分配利润 8,449.09 万元的比例为 69.13%。

为保持公司的可持续发展，公司历年滚存的未分配利润作为公司业务发展资金的一部分，继续投入公司生产经营。

三、未来三年股东回报规划

为进一步增强华正新材利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会 2012 年 5 月 4 日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及 2013 年 11 月 30 日发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监发[2013]43 号），上海证券交易所 2013 年 1 月 7 日发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，公司董事会制定了《浙江华正新材料股份有限公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》，回报具体如下：

（一）制定规划的基本原则

公司应当根据当年盈利状况和持续经营的需要，实施积极、连续、稳定的股利分配政策，重视对投资者的合理投资回报，切实维护投资者合法权益。

（二）制定规划考虑的因素

公司应着眼于长远和可持续发展，在综合考虑市场环境、公司盈利能力、经营发展规划前提下，建立对股东持续、稳定、科学的回报计划与机制，重视股东的合理投资回报，为股东提供分享经济增长成果的机会，保持利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾全体股东的整体利益和公司的长远利益及可持续发展。

（三）公司未来三年（2019-2021年）的具体股东回报规划

1、公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

2、在公司当年盈利且公司累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配。公司可以进行中期或季度利润分配。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期或季度分红。

3、除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，进行利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

4、公司在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以采取发放股票股利的方式分配利润。

（四）股东回报规划制定周期和决策机制

公司每3年审议一次股东回报规划，公司董事会根据公司预计经营状况、股东尤其是中小投资者、独立董事以及监事会意见，制定该时段股东回报规划，董事会审议通过后提交公司股东大会审议批准。

第七节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和计算，现将本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施公告如下：

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

公司本次非公开发行募集资金总额将不超过 65,000 万元，非公开发行股票数量不超过 25,870,000 股。公司就本次非公开发行对发行当年公司主要财务指标的影响做了相关测算，具体测算过程如下：

（一）主要假设

1、假设本次非公开发行于 2019 年 9 月 30 日实施完毕，该时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终发行实施完毕时间应以经中国证监会等监管部门核准后实际发行完成时间为准；

2、假设宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化，公司经营环境未发生重大不利变化；

3、在预测公司总股本时，以本次非公开发行前总股本 129,350,000 股为基础，仅考虑本次非公开发行股票的影响，不考虑其他因素（如资本公积转增股本、股票股利分配）导致公司总股本发生的变化；

4、假设本次非公开发行的发行股数和募集资金金额均按照上限计算，即假设本次非公开发行股票数量和募集资金金额分别为 25,870,000 股和 65,000 万元；

该发行股票数量和募集资金金额仅为公司用于本测算的估计，最终以经中国证监会核准后实际发行股票数量和募集资金金额为准；

5、对于2019年度净利润，假设按三种情况进行测算，即2019年度扣非前及扣非后归属于母公司所有者的净利润分别较2018年下降10%、持平 and 增长10%。以上仅为基于测算目的的假设，不构成承诺及盈利预测，投资者不应根据此假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；

6、未考虑本次非公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响，本次测算也不考虑发行费用；

7、假设公司2019年现金分红政策及分红时间与2018年一致。

（二）对公司主要财务指标的影响

在上述情景下，对本次非公开发行摊薄即期回报对2019年度主要财务指标的影响进行了测算，具体情况如下：

项目	2018年度 /2018年12月 31日	2019年度/2019年 12月31日	2019年度 /2019年12月 31日
		未考虑本次发行	考虑本次发行
总股本（股）	130,670,000	129,350,000	155,220,000
1、假设2019年度扣非前及扣非后归属于母公司所有者的净利润分别较2018年下降10%			
归属于母公司所有者的净利润（万元）	7,508.03	6,757.23	6,757.23
归属母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润（万元）	5,860.45	5,274.41	5,274.41
当年分红金额（万元）	1,960.05	1,940.25	2,328.30
归属母公司所有者的权益（万元）	67,392.87	70,522.89	135,134.84
基本每股收益（元/股）	0.58	0.52	0.50
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.52	0.50
扣除非经常性损益的基本每股收益（元/股）	0.45	0.41	0.39
扣除非经常性损益的稀释每股收益（元/股）	0.45	0.41	0.39
加权平均净资产收益率	11.67	9.90	8.02
扣除非经常性损益的加权平均净资产	9.11	7.73	6.26

收益率			
2、假设 2019 年度扣非前及扣非后归属于母公司所有者的净利润分别较 2018 年持平			
归属于母公司所有者的净利润(万元)	7,508.03	7,508.03	7,508.03
归属母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润(万元)	5,860.45	5,860.45	5,860.45
当年分红金额(万元)	1,960.05	1,940.25	2,328.30
归属母公司所有者的权益(万元)	67,392.87	71,273.69	135,885.64
基本每股收益(元/股)	0.58	0.58	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.58	0.55
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.45	0.45	0.43
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元/股)	0.45	0.45	0.43
加权平均净资产收益率	11.67	10.94	8.87
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	9.11	8.54	6.92
3、假设 2019 年度扣非前及扣非后归属于母公司所有者的净利润分别较 2018 年增长 10%			
归属于母公司所有者的净利润(万元)	7,508.03	8,258.83	8,258.83
归属母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润(万元)	5,860.45	6,446.50	6,446.50
当年分红金额(万元)	1,960.05	1,940.25	2,328.30
归属母公司所有者的权益(万元)	67,392.87	72,024.49	136,636.44
基本每股收益(元/股)	0.58	0.64	0.61
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.64	0.61
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.45	0.50	0.47
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元/股)	0.45	0.50	0.47
加权平均净资产收益率	11.67	11.97	9.72
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	9.11	9.34	7.58

注 1: 考虑本次发行后期末归属于母公司所有者权益=期初归属于母公司所有者权益+归属于母公司所有者的净利润+本次发行融资额;

注 2: 未考虑本次发行的基本每股收益=当期归属于母公司所有者净利润/发行前总股本; 考虑本次发行后基本每股收益=当期归属于母公司所有者净利润/(发行前总股本+新增加股份次月起至报告期期末的累计月数/12*本次发行完成后新增股份数);

注3:未考虑本次发行的基本每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/发行前总股本;考虑本次发行后每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/(发行前总股本+本次发行完成后新增股份数);

注4:加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润/(期初归属于母公司股东的净资产+新增净资产次月起至报告期期末的累计月数/12*本次发行募集资金总额+当期归属于母公司所有者净利润/2)。

二、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行募集资金到位后,本公司的总股本和净资产将有一定幅度的增加,但本次募集资金不能立即产生相应幅度的收益,因此短期内对公司业绩的增长贡献可能较小,公司长期股东回报的提升仍需通过进一步做强主业、提升公司核心竞争力来实现。因此,本次发行完成后,在短期内公司存在每股收益和净资产收益率下降的风险,特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

三、本次非公开发行股票的必要性和合理性

本次非公开发行股票募集资金投资项目均经过公司董事会谨慎论证,项目的实施有利于扩大公司生产规模、提升公司的核心竞争力,巩固公司行业地位,增强公司的可持续发展能力,具体分析详见公司同日刊登的募集资金投资项目可行性分析报告公告。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一) 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司主要从事覆铜板材料、功能性复合材料和热塑性蜂窝材料等复合材料及制品的设计、研发、生产及销售,产品广泛应用于通讯信息交换系统、云计算储

存系统、自动驾驶信号采集系统、物联网射频系统、医疗设备、轨道交通、新能源、绿色物流等各大领域。

本次募集资金将主要用于年产 650 万平米高频高速覆铜板青山湖制造基地二期项目。通过本次募投项目建设，公司每年将新增 650 万平方米高频高速覆铜板产能，该项目所产的高频高速覆铜板是面向下一代 5G 高速通信应用的产品，将帮助公司抓住下一代 5G 高速通信应用快速发展的机遇，进一步提升公司核心竞争力和市场占有率。

（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

人员方面，公司多年来注重内部员工的专业化培训和技能提升，并建立了与业务运营相匹配的管理制度。目前，公司已形成科学的公司治理架构和精益高效的管理模式，拥有一支经验丰富且实干型的经营管理团队。同时公司在发展过程中，根据行业变动情况，持续加大人才引进和培养力度，陆续引进和储备了一批行业内的优秀人才，能够充分胜任本次非公开发行的募集资金投资项目的要求。

技术方面，公司建立了完善的研发体系，掌握了高频高速覆铜板的生产工艺。在高频覆铜板领域，公司高频项目 H5 系列产品实现量产，产品已进入重要终端的供应链；公司还实现了高频产品的技术突破，开发了 HC 系列和 HN 系列产品，丰富了 PTFE 系列和碳氢系列的产品种类，以更好的满足未来 5G 通讯、汽车自动驾驶、超高频雷达等领域的需要。在高速覆铜板领域，公司研究开发了品种丰富、性能优异稳定的高速基材产品系列，部分产品已通过国内知名大型通讯公司的技术认证，并进入其材料库，目前已在批量生产中。同时，公司以青山湖先进制造基地一期为样板，通过引进 EMS、ERP、WMS、SCADA 等软件系统，搭建车间制造执行系统，实现了业务管理层与生产现场的有机结合。并针对本行业生产工艺特点，开发应用了一系列智能制造装备和物联网仓储系统，实现生产过程的自动化、可视化、数字化、智能化。

市场方面，经过前期和终端客户的合作开发，公司生产的高频、高速及多层印制电路用覆铜板部分产品已通过部分知名企业的终端技术认证，具备批量供货

资格。凭借公司多年从事覆铜板行业累积的经验与客户资源，公司已建立起了覆盖全国各地和海外市场的销售网络，在市场方面已经做了充分准备。

五、本次非公开发行摊薄即期回报填补的具体措施

（一）严格执行募集资金管理制度

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次发行募集资金到位后，公司董事会将继续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

（二）加快募集资金投资项目进度，提高资金使用效率

公司董事会已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募集资金投资项目符合产业发展趋势和国家产业政策。公司将抓紧进行本次募投项目的前期工作，积极调配资源，统筹合理安排项目的投资建设，力争缩短项目周期，实现本次募集资金投资项目的早日运营并实现预期效益。

（三）加强经营管理和内部控制，提升经营效率

公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投融资决策程序，提升资金使用效率。同时，公司也将加强企业内部控制，推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本控制，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。

（四）严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定的要求，公司制定了未来三年（2019-2021年）股东回报规划。本次非公开发行股票后，公司将依据

相关法律规定，严格执行落实现金分红的相关制度和股东分红回报规划，保障投资者的利益。

六、关于确保公司本次非公开发行填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的相关承诺

（一）公司董事、高级管理人员作出的承诺

根据公司董事、高级管理人员出具的《浙江华正新材料股份有限公司董事及高级管理人员关于摊薄即期回报及采取填补措施的承诺函》，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：

“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、如公司拟实施股权激励，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。

7、本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

（二）公司控股股东及实际控制人作出的承诺

华正新材控股股东华立集团及实际控制人汪力成先生出具了《浙江华正新材料股份有限公司控股股东及实际控制人关于摊薄即期回报及采取填补措施的承诺函》，承诺如下：

- “1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
- 2、本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本企业承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。
- 3、如违反上市承诺对上市公司造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。”

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2019年4月26日